



特点

- 国际标准封装，芯片与底板电气绝缘耐压3000V
- 采用进口玻璃钝化芯片焊接式结构，优良的温度特性和功率循环能力
- 350A以下模块皆为强迫风冷，400A以上模块，风冷，水冷选用

典型应用

- 直流电源，各种稳压电源
- 工业加热控制
- 电机软起动，整流电源
- 变频器，充电机，电池充放电

IT(AV)	44A
VDRM/VRRM	600-2400V
ITSM	0.96 KA
I ² t	5.6 10 ³ a ² s

符号	参数	测试条件	结温 Tj(°C)	参数值			单位
				最小	典型	最大	
IF(AV)	正向平均电流	180° 正弦半波, 50HZ 单面散热, Tc=100°C	150		44	50	A
IF(RMS)	方均根电流		150			63	A
VRRM	反向重复峰值电压	VRRM tp=10ms VRSM=VRRM+200V	150		1600		V
IRRM	反向重复峰值电流	VRM=VRRM	150			5	mA
IFSM	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波 VR=0.6VRRM	150			0.96	KA
I ² t	浪涌电流平方时间积					5.6	A ² S*10 ³
VFO	门槛电压		150			0.80	V
rF	斜率电阻					6.32	mΩ
VFM	正向峰值电压	IFM=132A	25			1.1	V
Rth(j-c)	热阻抗(结至壳)	180° 正弦波, 单面散热				0.53	°C/W
Rth(c-h)	热阻抗(壳至散)	180° 正弦波, 单面散热				0.2	°C/W
Viso	绝缘电压	50Hz,R.M.S,t=1min,Iiso:1mA(max)			3000		V
FM	安装扭矩(M5)				3		N-m
	安装扭矩(M6)				4		N-m
Tstq	储存温度			-40		125	°C
Wt	质量						g
Outline	外形	92 X 20mm					

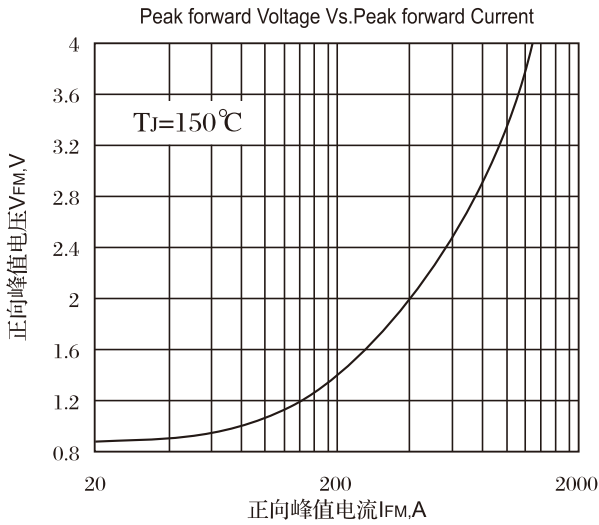


Fig.1 正向伏安特性曲线

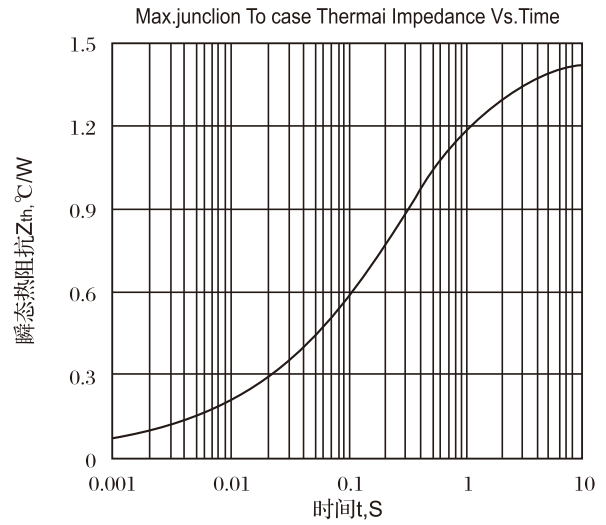


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

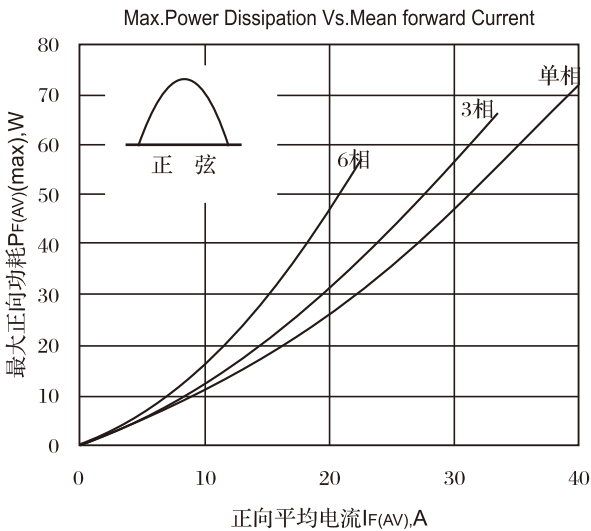


Fig.3 最大正向功耗与平均电流关系曲线

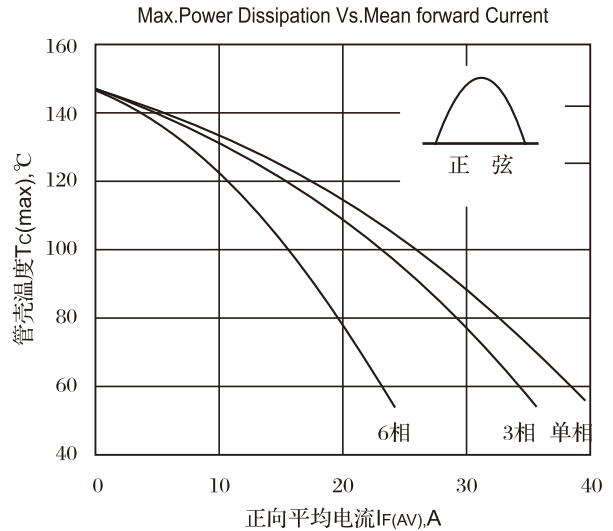


Fig.4 管壳温度与正向平均电流关系曲线

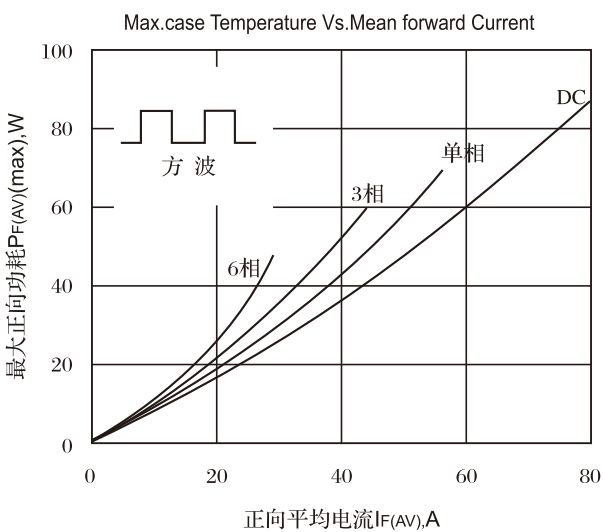


Fig.5 最大正向功耗与平均电流关系曲线

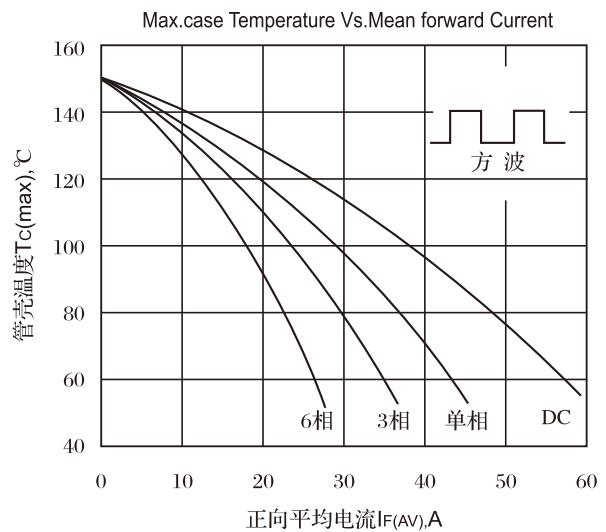


Fig.6 管壳温度与正向平均电流关系曲线

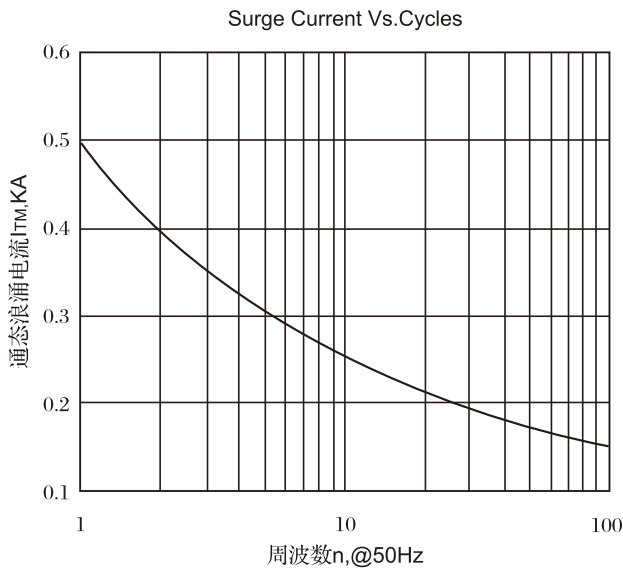


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

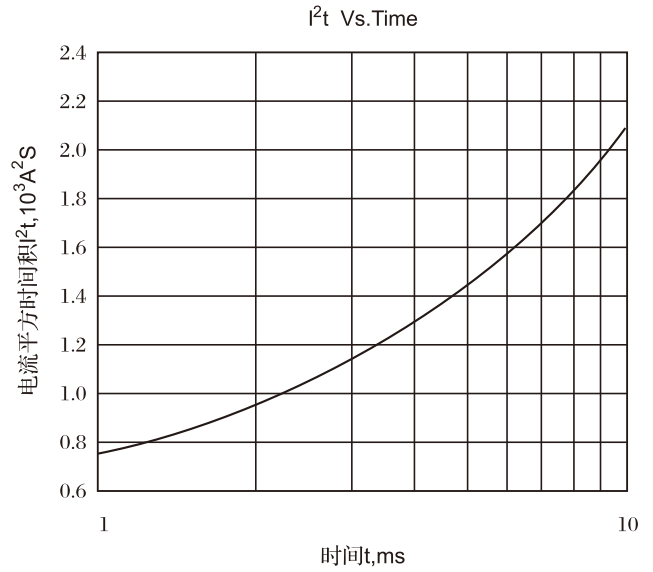
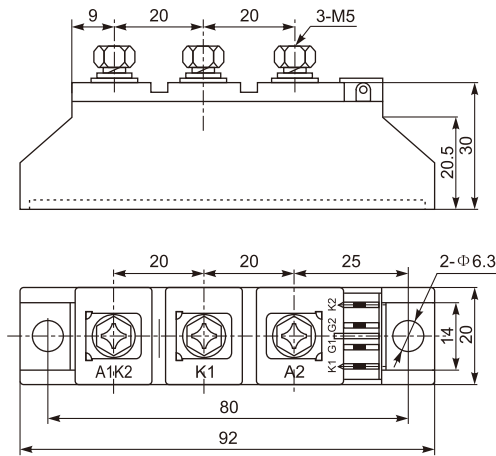


Fig.8 I²t 特性曲线

外形图:



线路图:

MD

